

E

D

1:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

5

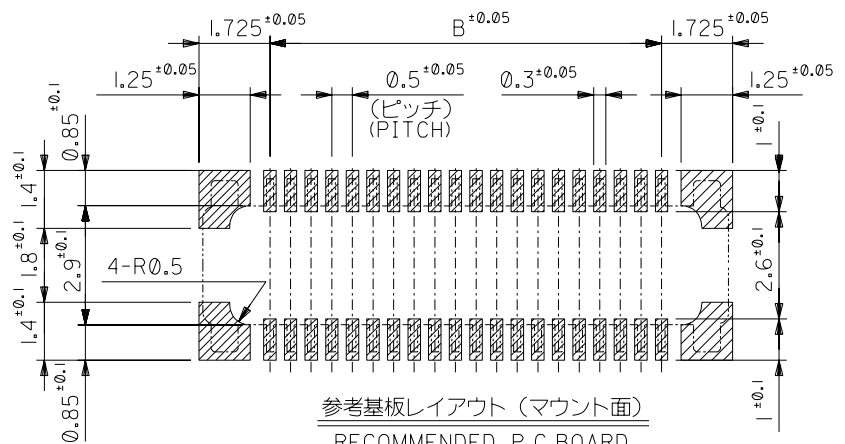
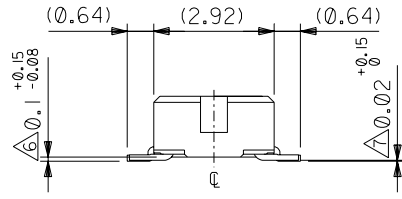
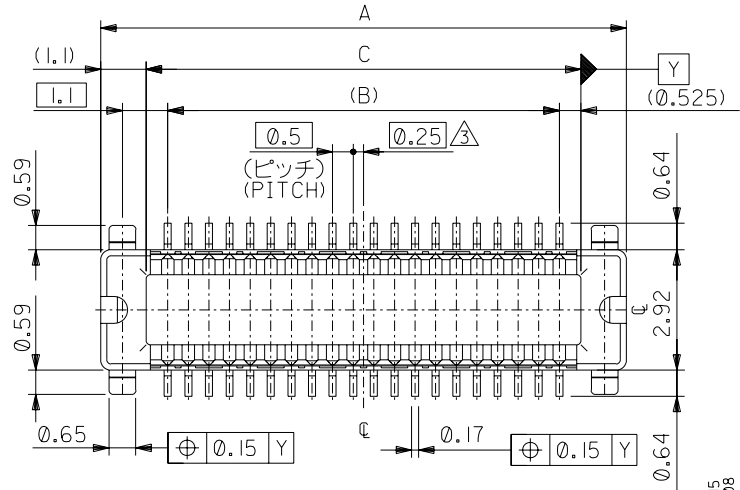
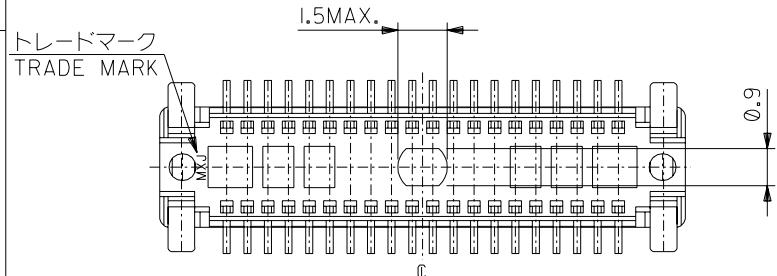
4

3

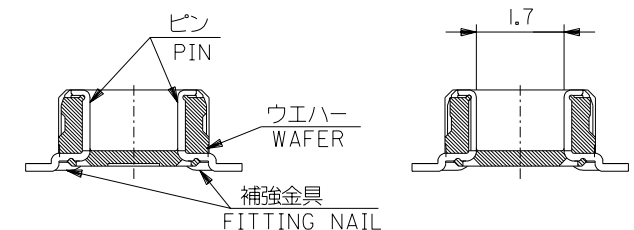
2

1

トレードマーク
TRADE MARK



参考基板レイアウト (マウント面)
RECOMMENDED P.C. BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)
(MOUNTING AREA)



SECT.W-W(LOCK PART)

SECT.V-V(W/O LOCK PART)

	NONE	20.55	19.5	22.75	53949-0871	80
		18.05	17.0	20.25	53949-0771	70
	10,21	15.55	14.5	17.75	53949-0671	60
53949-***71	4,10,16,22	13.05	12.0	15.25	53949-0571	50
MODEL NO.	LOCK POSITION	C	B	A	MATERIAL NO.	CIRCUIT

材料 MATERIAL		SHEET 2 OF 2 参照		REFER TO SHEET 2 OF 2		仕上げ FINISH		適用電線範囲 WIRE RANGE		被覆外径 INS. RANGE		DRAWN BY 04/02/16 H.KAWABATA		CHK'D BY 04/02/16 K.TOJO		DWG. NO. SHEET 1 OF 2		REV 0	
角度 ANGLE		30°		30°以上 OVER		10°以上 OVER 30°未満 UNDER		10°未満 UNDER		一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		日付 DATE		尺度 SCALE	
0		新規作成 PROPOSED (J2004-2611)		04/02/16		04/02/16		04/02/16		04/02/16		04/02/16		04/02/16		04/02/16		04/02/16	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

8

7

6

5

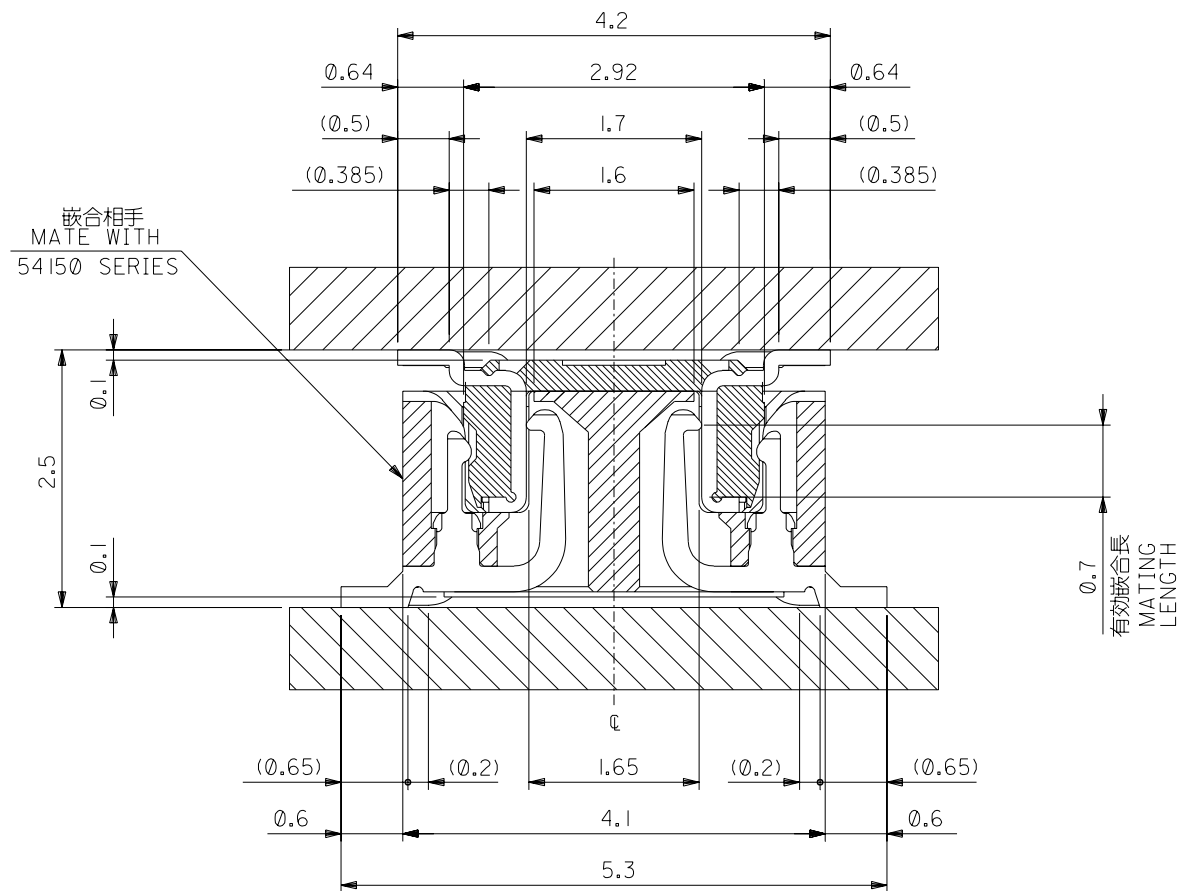
4

3

2

1

SD-53949-006.S01

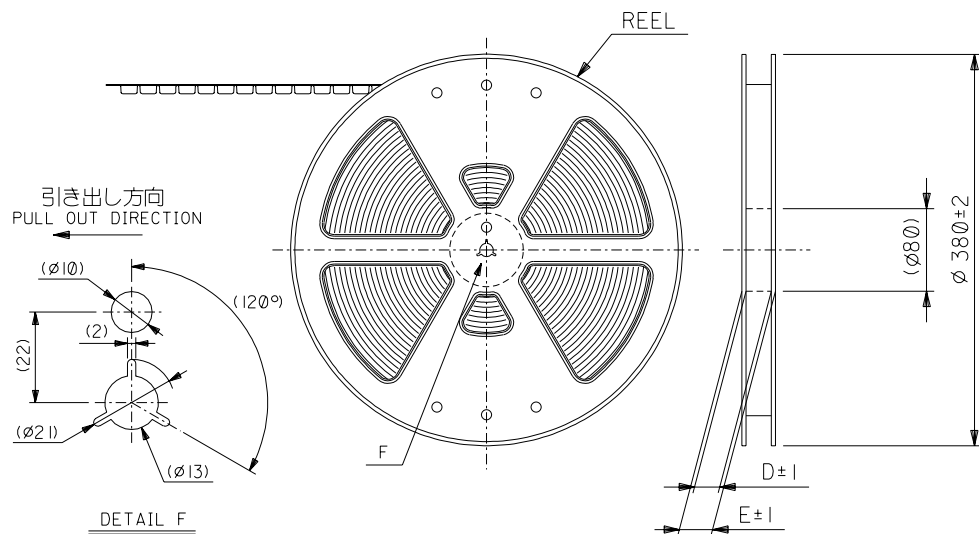


嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

注記 NOTES:

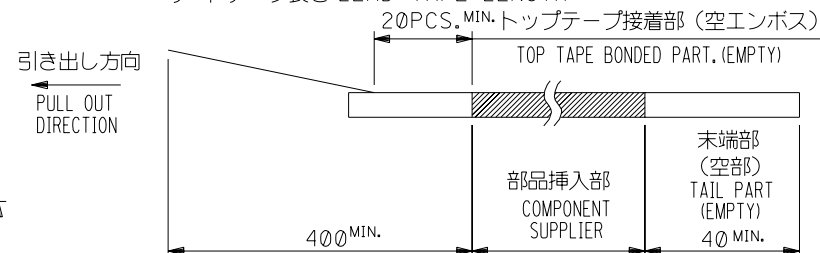
- 1 使用材料 MATERIAL
ハウジング: 液晶ポリマー (LCP) ガラス充填 UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP)
(GLASS FILL)UL94V-0 (COLOR:BLACK)
ターミナル: 黄銅 (t=0.15)
TERMINAL: BRASS(t=0.15)
補強金具: リン青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE(t=0.15)
- 2 メッキ仕様 PLATING
コンタクト部: 金メッキ
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
テール部: 金メッキ
TAIL AREA: GOLD 0.4 MICROMETER MINIMUM
ターミナル部下地メッキ: ニッケルメッキ
UNDER PLATING: NICKEL (TERMINAL AREA)
1.5 MICROMETER MINIMUM
補強金具: 錫メッキ
FITTING NAIL: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
補強金具下地メッキ: ニッケルメッキ
UNDER PLATING: NICKEL (FITTING NAIL)
1.0 MICROMETER MINIMUM
(全極数/2)=偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
- 4 嵌合相手: 54150シリーズ。
MATE WITH: 54150 SERIES.
- 5 テール及びネイルの平坦度は、0.1MAX。
TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.
テール部に適用。
APPLY TO THE TAIL AREA.
テールとネイルのズレ量。
OFFSET BETWEEN TAIL AND NAIL.
8. 本製品は 53949-***I の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53949-***I.

				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		—//—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		TITLE 名称 0.5 B-To-B PLUG Assy	
				被覆外径 INS. RANGE		—//—		WITH NAIL (Hg+=2.5)	
				DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	
				APP'D BY '04/02/16 M.SASAO		尺度 SCALE —//—		SD-53949-006	
				LEAD FREE				REV 0	
角度 ANGLE		±3°		新規格作成 PROPOSED (J2004-2611)		04/02/16			
30 以上 OVER		+0.3							
10 以上 30 未満 OVER UNDER		+0.25							
10 未満 UNDER		+0.2							
一般公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	



NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-53949-006 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-53949-006.
- 梱包数量：3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：0.1～1.3N {10～130gf}

(剥離方向は下図参照)

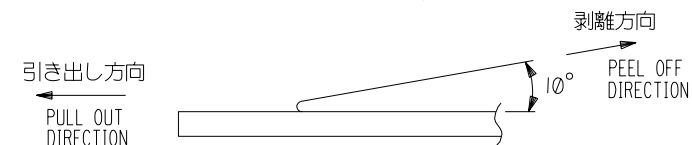
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1～1.3N {10～130gf}

(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



- 材料(MATERIAL)

キャリアテープ(CARRIER TAPE)：ポリプロピレン(POLYPROPYLENE(PP))

トップテープ(TOPTAPE)：PET , PE , PEF

リール(REEL)：ポリスチレン (PS)(POLYSTYRENE(PS))

リサイクル材を含む (RECYCLE MATERIAL CONTAINED)

- 本製品は 53949-***8 の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53949-***8.

						材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
						仕上げ FINISH	—#—	
						適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
						被覆外径 INS. RANGE	—#—	TITLE 名称
						DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO	0.5 B-To-B PLUG Assy W/NAIL (Hgt=2.5) Embstp Pkg -LEAD FREE-
						APPR'D BY '04/02/16 M.SASAO	尺度 SCALE —#—	DWG. NO. (SHEET 1 OF 3)
						記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	SD-53949-007
						DR. CHK.	日付 DATE	REV
						一般公差 GENERAL TOLERANCES		0

DWG. NO.
SD-53949-007

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

8

7

6

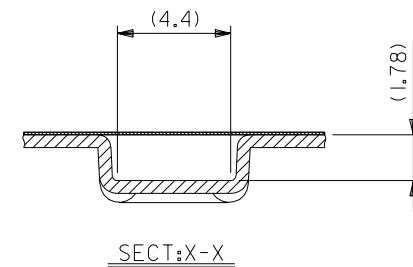
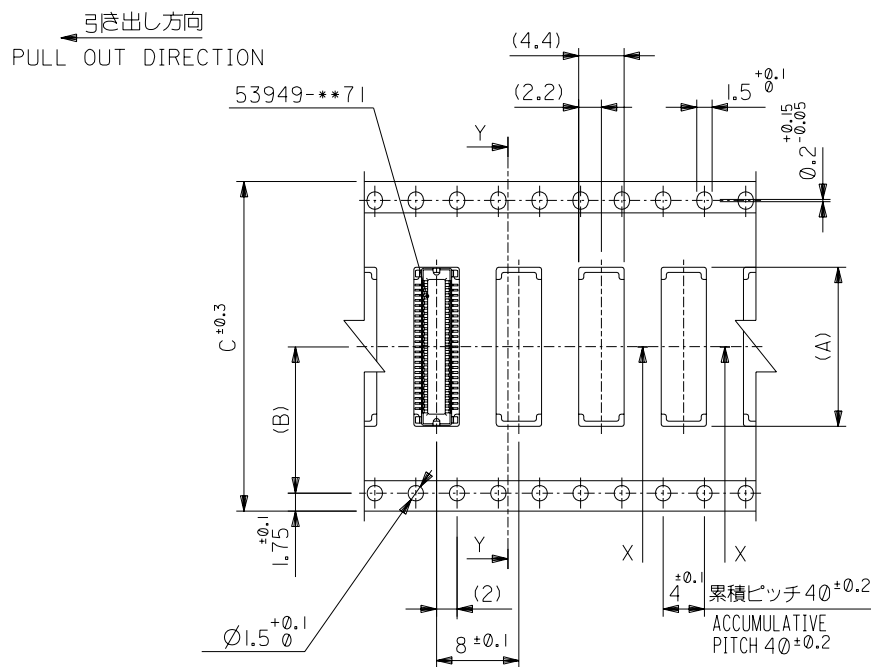
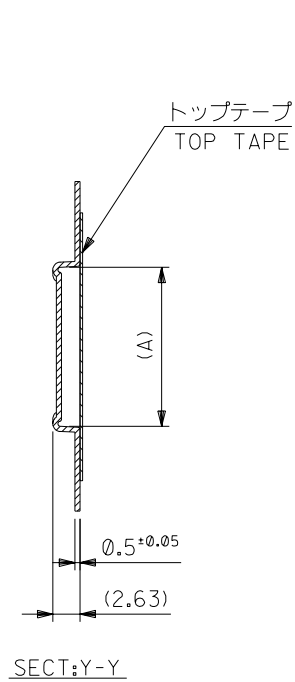
5

4

3

2

1



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

53949-**78	32	37.4	33.4	32	14.2	20.45	53949-0778	70
MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	17.95	53949-0678	60
						15.45	53949-0578	50
						(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT
						材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3		
						仕上げ FINISH —#—		
						適用電線範囲 WIRE RANGE —#—		
						被覆外径 INS. RANGE —#—		
						DRAWN BY '04/02/16 H.KAWABATA		
						CHK'D BY '04/02/16 K.TOJO		
						APP'D BY '04/02/16 M.SASAO		
						尺度 SCALE —#—		
						REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
						TITLE 名称 0.5 B-To-B Conn PLUG Assy W/ NAIL Embst+p Pkg -LEAD FREE-		
						DWG. NO. (SHEET 2 OF 3) REV SD-53949-007 0		

角度 ANGLE	$\pm 30^\circ$	
30 以上 OVER	± 0.5	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	± 0.25	
未満 UNDER	± 0.2	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
0	新規作成 (J2004-2611)	Y.K.	'04/02/16

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

SD-53949-007.S02

DWG. NO.
SD-53949-007

E

D

C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

F

E

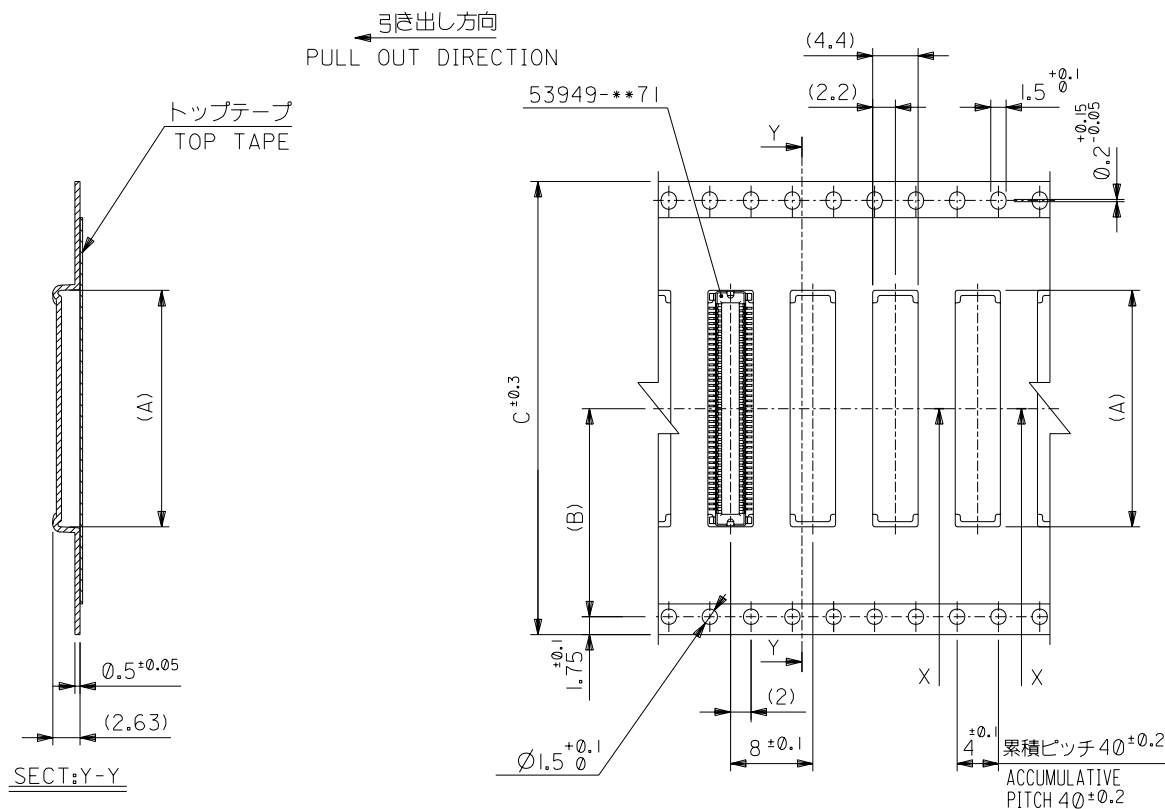
D

C

B

A

SD-53949-007.S03



4.4mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

53949-**78	44	49.4	45.4	44	20.2	22.95	53949-0878	80
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	CIRCUIT
							材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	
							molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
							仕上げ FINISH —	
							適用電線範囲 WIRE RANGE —	
							被覆外径 INS. RANGE —	
							DRAWN BY 04/02/16 H.KAWABATA CHK'D BY 04/02/16 K.TOJO	
							DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV	
							SD-53949-007 0	
							尺度 SCALE —	
角度 ANGLE	±3°							
30 以上 OVER	±0.5							
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25							
10 未満 UNDER	±0.2							
一般公差 GENERAL TOLERANCES	0	新規作成 PROPOSED (J2004-2611)	04/02/16					
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE				

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32